

Descrizione del prodotto

- 100% nuovo e di alta qualità !!
- Il flusso di colofonia viene utilizzato per facilitare la saldatura.
- Pulisce e previene l'ossidazione del metallo che consente alla saldatura di creare legami meccanici ed elettrici forti e duraturi.
- Agisce anche come agente bagnante, aumentando il flusso di saldatura e l'efficienza del processo di saldatura.
- Perfetto per telefoni cellulari, schede PC e altre sofisticate saldature elettroniche a livello di chip.

specificazioni

Prodotto: BST-706

Punto di fusione: 138 °C

Peso: 500g

Ingredienti: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature



500g

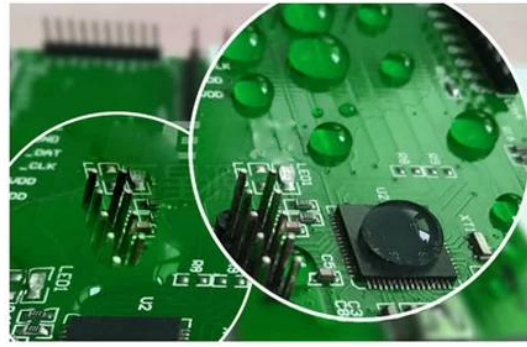
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

Product Usage

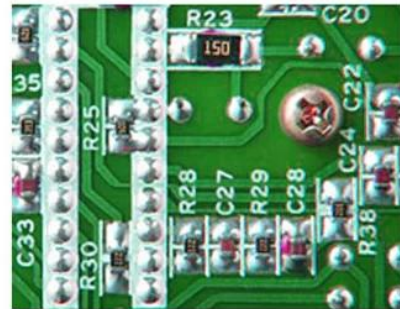
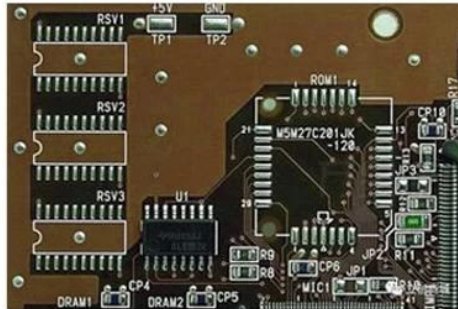


MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



52MM

75MM

